

ポリイミドベース銅張積層板 ユピセル® N / エクシラム® NT

特長

ユピセルN/エクシラムNT は、UBE株式会社製の熱融着性PIフィルム：ユーピレックス®VT/
東レ・デュポン株式会社製の熱融着性PIフィルム：カプトン®AENCを用いた接着剤レスの銅貼積層板です。

対応範囲

		銅箔厚み(μm)										
		2	3	6	9	12	18	35	70	105	150	300
PI厚み (μm)	12.5	○	○	○	○	○	○	○	●	○	●	●
	25	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	50	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	75	●	●	●	●	○	○	○	●	●	●	●
	100	●	●	●	●	○	○	○	●	●	●	●

○：ラミネート実績あり ●：ラミネート実績なしも技術的に可能

一般特性

グレード			BR3120B8A	BTR3120B8A	備考	
厚み構成 Cu/絶縁層/Cu(μm)			105/50/105		—	
PIフィルム(メーカー)			VT(UBE)	AENC(東レ・デュポン)		
銅箔種			圧延箔		—	
ピール強度	常態		N/mm	>1.5	>1.5	UEXC法
寸法変化率	銅箔エッチング後	MD	(%)	0.00	0.06	UEXC法
		TD		0.00	0.04	
	熱処理後 150°C×30分	MD		-0.02	0.06	
		TD		-0.02	0.04	
半田耐熱性	300°C×1分		—	Pass	Pass	UEXC法

長期信頼性 表：ピール強度評価結果(N/mm)

処理条件		初期	1000hr
BR3120B8A	150°C	>1.5	>1.5
	85°C×85%RH	>1.5	>1.5
BTR3120B8A	150°C	>1.5	>1.5
	85°C×85%RH	>1.5	>1.5

・1000hr経過後も
強度低下はありません。

- 一般特性および伝送損失特性については代表値であり、保証値ではありません。
- 記載されているデータは見直されることがあります。

「ユピセル」、「ユーピレックス」は、UBE(株)の日本における登録商標です。
「エクシラム」は宇部エクシモ(株)の日本における登録商標です。
「カプトン」はDuPont de Nemours, Inc.の商標又は登録商標です。